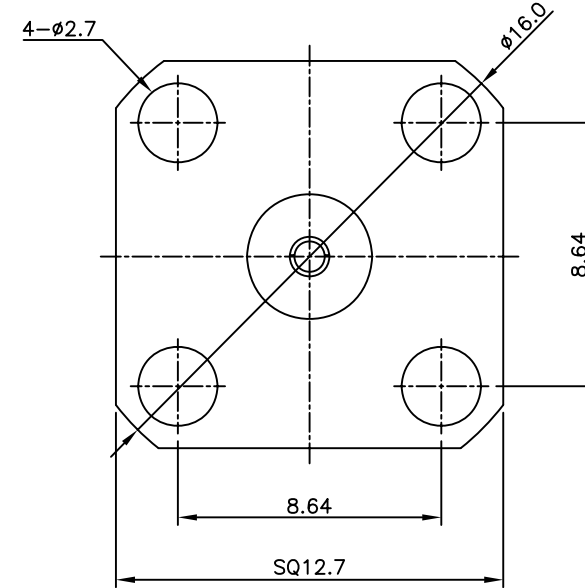
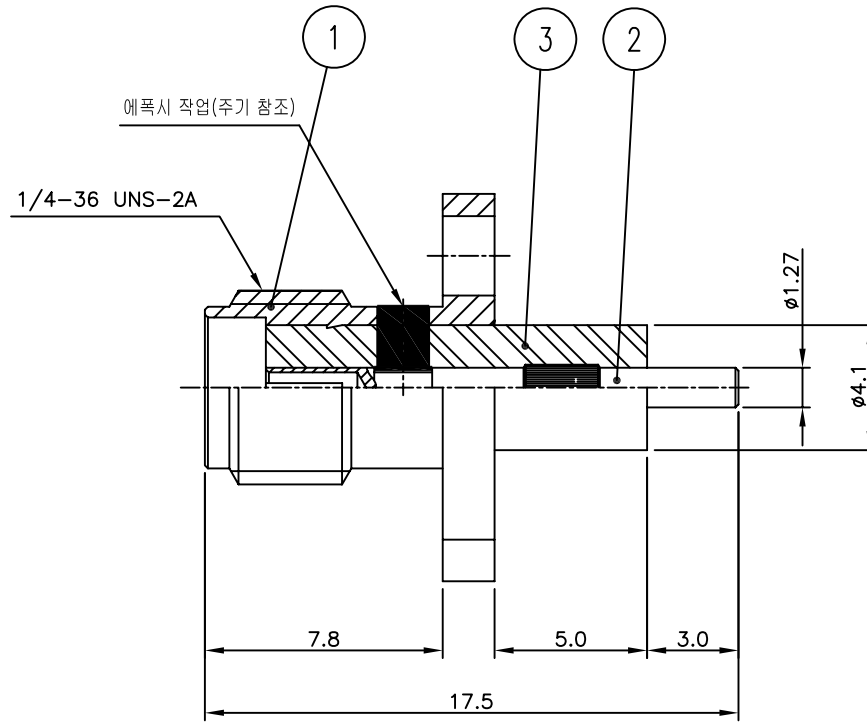


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2008.06.02.
1	바디 납시바늘 추가 및 절연체 공용화로 인한 코드 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2020.12.24.
2	코드 통일화로 인한 원제품 코드 변경 (CN02023-7/1 → CN02039-7/5)	S.Y.EUN	I.C.KIM	2021.08.19.



주 기

- 에폭시는 RoHS 지침에 적합한 제품을 사용한다.
- 절연체 조립 후 Hole 작업 $\phi 1.7 \rightarrow$ PIN 조립 후 에폭시 주입할 것

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02077-N/1 DIN00156-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00218-5/1
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00370-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2021. 08. 19.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL	-	CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE SMA50 SOLDER END JS-4H
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH	-	SCALE	4/1	DWG NO. CN02039-7/5
		UNIT	mm	REVISION 2
				SHEET 1 of 1